



半自动激光锡球喷射焊锡机

一、设备介绍

激光锡球焊锡机 采用非接触式加热方式——激光作为热源，氮气作为动力将熔化的锡球喷出，整个焊锡过程为非接触式，可精准控制焊点锡量和焊锡高度；焊接时无飞溅、无残留免清洗；焊接速度快；设备通用性强，可离线，也可对接自动化生产线；



二、技术参数

部件	参数	部件	参数	
激光参数	功率: 75W 可选	机械重复精度	±0.005mm	
	波长: 1064±5nm		视觉定位系统	CCD: 5Million Pixels
	模式: 连续/脉冲			解析度: ±5um
锡球规格	Ø0.25mm	外形尺寸	1000*1100*1650mm	
控制方式	PLC 动作、 PC 图像处理	载盘尺寸	<110*130mm	
主机重量	550kg	电源	单相 AC220V, 15A	
功耗	3Kw	压缩气	0.6MPa	

三、应用领域

- ◆适用各种异型焊锡、表面搭接、贴装，精密零件、对 FLUX 助焊剂敏感器件焊锡；
- ◆微电子行业：高清摄像模组，手机、数码相机 FPC 焊接，声控器件，数据线，传感器；
- ◆军工电子制造业：军工、航空航天高精密电子产品焊接；
- ◆其他行业：晶圆，光电子产品，汽车电子，MEMS，BGA 等

特点：

- 1、适用于高精度焊接，精度±10um，产品最小间隙 100um；
- 2、锡球范围可供选择范围大，直径 300~760um（760um 以上可定制）；
- 3、镀锡、金、银的金属表面，良率 99%以上。
- 4、自动 Z 轴精度调焦平台；
- 5、自动测高功能；
- 6、焊后 AOI 外观检测（选配）；
- 7、兼容四面焊治具，可 360° 旋转。

四、应用实例

